

2023-2029年中国LED封装市场深度评估与投资战略研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国LED封装市场深度评估与投资战略研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202305/359601.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

2017年全球LED封装行业市场规模达到1,439亿元。目前全球LED封装产业主要集中于中国大陆、日本、中国台湾地区、美国、欧洲、韩国等国家和地区。根据LEDinside资料，全球排名靠前的封装企业陆续在我国设厂，并且已经在我国封装市场占有一定的市场份额。目前，中国已成为全球LED封装行业的最大制造基地。

中国LED封装行业发展初期主要以LED照明封装为主，随着下游LED显示应用以及LED显示封装技术发展，国内LED显示封装细分行业规模亦不断扩张。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据，2018年中国LED封装行业产值约1,000亿元。预计中国LED封装行业产值规模将保持15.02%的复合增长率，2020年中国封装市场产值预计将达到1,290亿元。

中国LED封装行业企业数量自2010年以来持续攀升并于2014年达到峰值的1,532家；2015年起因行业竞争加剧，众多中小型封装企业在成本上升、价格下降的双重压力下，逐步退出市场，中国LED封装行业企业数量持续下降，预计2020年LED封装行业企业数量将会下降至约500家。

目前中国LED封装行业格局初定，LED封装行业领先企业利用规模、资本优势，进行有效的资源整合，向上、下游探索布局，市场逐步向领先企业集中。国内领先企业体量持续上升，在保持各自核心竞争力的基础上，不断丰富业务品种、优化产业链结构。

中企顾问网发布的《2023-2029年中国LED封装市场深度评估与投资战略研究报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第一章 LED封装相关概述

第一节 LED封装简介

一、LED封装的概念

二、LED封装的形式

三、LED封装的结构类型

四、LED封装的工艺流程

第二节 LED封装的常见要素

一、LED引脚成形方法

- 二、LED弯脚及切脚
- 三、LED清洗
- 四、LED过流保护
- 五、LED焊接条件

第二章 LED封装产业总体发展分析

第一节 世界LED封装业的发展

- 一、发展概况
- 二、总体特征
- 三、区域分布

第二节 中国LED封装业的发展

- 一、发展现状
- 二、产值增长情况
- 三、产量增长情况
- 四、价格分析
- 五、利好因素

第三节 国内重要LED封装项目的建设进展

第四节 SMDLED封装

第五节 LED封装业发展中存在的问题

第六节 促进中国LED封装业发展的策略

第三章 中国LED封装市场格局分析

第一节 LED封装市场发展态势

第二节 LED封装企业发展格局

第三节 广东省LED封装业

- 一、主要特点
- 二、重点市场
- 三、发展趋势

第四节 LED封装市场竞争格局

第五节 LED封装企业竞争力简析

第四章 LED封装行业技术研发进展状况

第一节 中外LED封装技术的差异

一、封装生产及测试设备差异

二、LED芯片差异

三、封装辅助材料差异

四、封装设计差异

五、封装工艺差异

六、LED器件性能差异

第二节 中国LED封装技术发展概况

一、封装技术影响LED产品可靠性

二、中国LED业专利集中在封装领域

三、中国LED封装业的技术特点

四、LED封装技术水平不断提升

五、LED封装业技术研发仍需加强

第三节 LED封装关键技术介绍

一、大功率LED封装的关键技术

二、显示屏用LED封装的技术要求

三、固态照明对LED封装的技术要求

第五章 LED封装设备及封装材料的发展

第一节 LED封装设备市场分析

一、我国LED封装设备市场概况

二、LED封装设备国产化亟需加速

三、发展我国LED封装设备业的思路

第二节 LED封装材料市场分析

一、LED封装主要原材介绍

二、我国LED封装材料市场简析

三、部分关键封装原材料仍依赖进口

四、LED封装用基板材料市场走向分析

第三节 LED封装支架市场

一、国内LED封装支架市场格局分析

二、LED封装支架技术未来发展趋势

三、我国LED封装支架市场前景广阔

第六章 LED封装重点企业介绍

第一节 国外主要LED封装重点企业

- 一、科锐 (CREE)
- 二、日亚化学 (NICHIA)
- 三、飞利浦 (Philips)
- 四、三星LED (SamsungLED)
- 五、首尔半导体 (SSC)

第二节 中国台湾主要LED封装重点企业

- 一、亿光电子
- 二、光宝集团
- 三、东贝光电
- 四、宏齐科技
- 五、台积电
- 六、艾笛森

第三节 中国内地主要LED封装重点企业

- 一、佛山市国星光电股份
- 二、木林森股份
- 三、苏州东山精密制造股份
- 四、深圳市晶台股份

第七章 2023-2029年中国LED封装产业发展趋势及前景

第一节 2023-2029年LED封装产业发展趋势

- 一、功率型白光LED封装技术发展趋势
- 二、LED封装技术将向模块化方向发展
- 三、LED封装产业未来发展走向分析

第二节 2023-2029年中国LED封装市场前景展望

第三节 中心投资建议

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202305/359601.html>